

お問合せ先  
OBARA GROUP株式会社  
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10  
TEL. 046-271-2122

適切に選別された森林からの原料を含むFSC®認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用  
して造ります。



[www.obara-g.com](http://www.obara-g.com)

# OBARA-G REPORT

## 第56期 第2 四半期報告書

2013年10月1日………2014年3月31日

証券コード 6877

## 株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2014年第2四半期連結累計期間（2013年10月1日から2014年3月31日まで）における事業の概況等をご報告致します。



当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国において景気回復の動きが持続したものの、アジアを始めとする新興国の経済成長の鈍化や欧州地域の不透明な景況感の継続などから、全体として低成長に推移しました。

我が国経済につきましては、依然として楽観できない状況が続いたものの、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などにより個人消費が増加するとともに、幅広い業種において企業収益が改善するなど、明るい兆しが見られました。

そのような外部環境の中、溶接機器関連事業が自動車メーカーの活発な生産活動や設備投資による需要拡大への対応を継続的に展開したことや、平面研磨装置関連事業がエレクトロニクス業界の緩やかな回復基調において顧客ニーズの発掘と迅速対応に注力したことなどにより、当社の業績は、前年同期を上回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、本年2月に129千株（自己株式を除く発行済株式総数の0.7%）の自己株式を取得するとともに、2014年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき20円とし、本年6月10日を支払開始日とさせていただきます。

今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2014年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	事業トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	

## 営業の概況

### 連結業績サマリー

(百万円)

	実績			通期の見通し	
	前第2四半期累計	当第2四半期累計	前年同期比	当期末(予想)	前期比
売上高	18,106	24,325	34.3%	44,500	15.3%
営業利益	3,121	5,038	61.4%	7,750	23.4%
経常利益	3,874	5,395	39.3%	8,150	11.0%
四半期(当期)純利益	2,326	3,576	53.8%	5,150	12.1%
1株当たり配当金	10(円)	20(円)	10(円)	40円(年間)	△10円

(注) 前期配当金の内訳(確定)／第2四半期末配当10円・期末配当40円(期末配当の内訳 普通配当30円・記念配当10円)  
 当期の第2四半期末配当(確定)／普通配当20円  
 当期の期末配当(予想)／普通配当20円

03

### 第2四半期連結累計期間の概況について

溶接機器関連事業と深く関わる自動車業界では、中国を中心としたアジア地域と米国及びメキシコなどの米州地域での自動車需要の拡大を背景として設備増強が行われるとともに、生産活動についても活発な動きが見られました。一方、同じく平面研磨装置関連事業と深く関わるエレクトロニクス業界では、総体的に設備投資及び生産活動に緩やかな回復が見られました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努めたことなどにより、第2四半期連結累計期間の業績は、前年同期に比べ増収増益となりました。

### 通期の見通しについて

第2四半期連結累計期間の業績及び足元の需要環境を踏まえて、平成26年3月27日に連結業績予想を上方修正しました。

溶接機器関連事業及び平面研磨装置関連事業とも日本を含むアジア地域での業績が順調に推移する見込みであることから、売上高445億円(前期比15.3%増)、営業利益77億50百万円(前期比23.4%増)、経常利益81億50百万円(前期比11.0%増)、当期純利益51億50百万円(前期比12.1%増)を予定しております。なお、当連結業績予想は、1米ドル=102円の為替レートを前提としています。

04

## セグメント別事業概況

溶接機器  
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

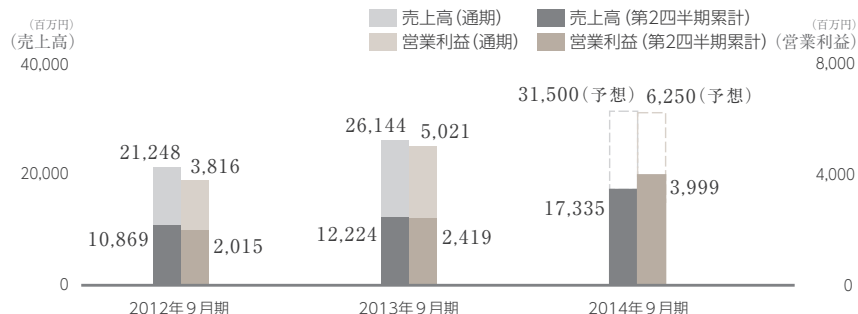
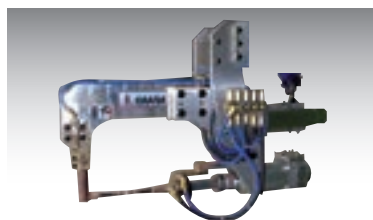
### OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

## 溶接機器関連事業



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・欧米系・アジア系自動車メーカーにおいて、中国を中心としたアジア地域や米国及びメキシコなどの米州地域などで積極的な増産投資が行われ、世界各地域の自動車生産は高水準となりました。このような環境の下、当事業として設備品の需要拡大への対応及び消耗品の拡販に努めたことなどにより、業績は好調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は173億35百万円(前年同期比41.8%増)となり、営業利益は39億99百万円(前年同期比65.3%増)となりました。

売上高構成比



## セグメント別事業概況

平面研磨装置  
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

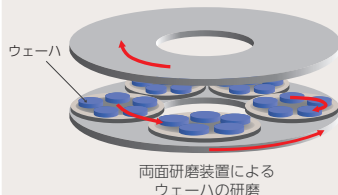
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程  
インゴット引き上げ、切断、  
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程  
成膜、リソグラフィ、  
エッチング等

半導体デバイス後工程  
ダイシング、ボンディング、  
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込  
完成した半導体デバイス(チップ)の  
エレクトロニクス製品への搭載

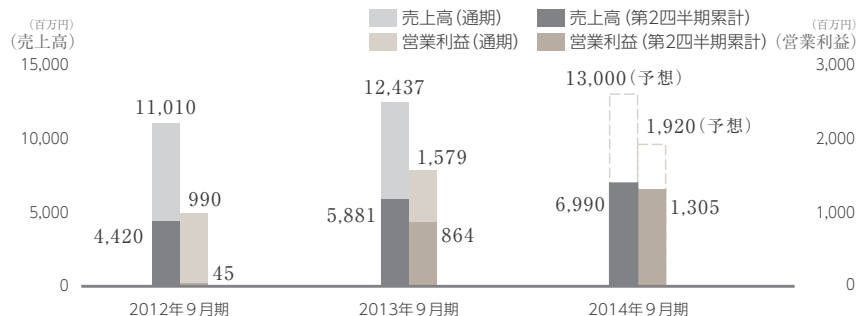


### OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

## 平面研磨装置関連事業



売上高構成比



平面研磨装置関連事業につきましては、スマートフォンやパソコンなど主要エレクトロニクス製品の堅調な販売動向などを受け、当事業の取引先であるエレクトロニクス関連素材においても、設備投資及び生産活動に緩やかな回復が見られました。このような環境の下、当事業として顧客要求に適合した販売深耕を各業界へ努めたことなどにより、業績は好調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は69億90百万円(前年同期比18.9%増)、営業利益は13億5百万円(前年同期比51.0%増)となりました。

## 事業トピックス

### 溶接機器関連事業

#### 2014国際ウェルディングショーに出展

2014年4月、当社は、東京ビッグサイトで開催された溶接・接合技術の総合展示会「国際ウェルディングショー」に出展し、当社の環境方針である「自然を尊重したモノづくりを通して、地球環境の改善に貢献する」ことをテーマに、環境負荷低減に取り組んだ溶接技術の総合ソリューションを提案しました。自動車ボディ向け軽量溶接ガンの実機デモンストレーションに加え、高精度の発振制御と多様なアプリケーションへのノウハウを持つ、独自の精密レーザー接合技術についても紹介し、多くの来場者からお問合わせを頂きました。



2014 国際ウェルディングショー

### 平面研磨装置関連事業

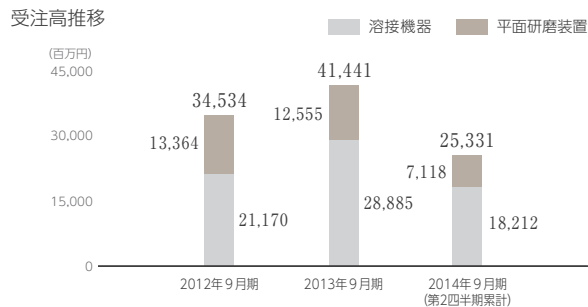
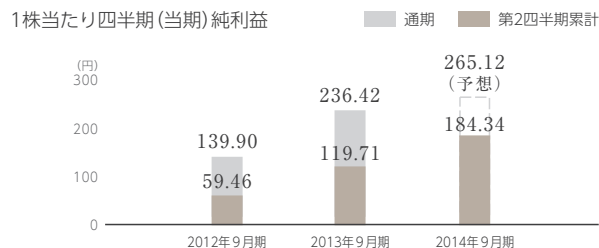
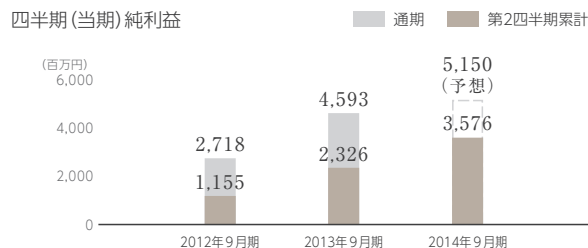
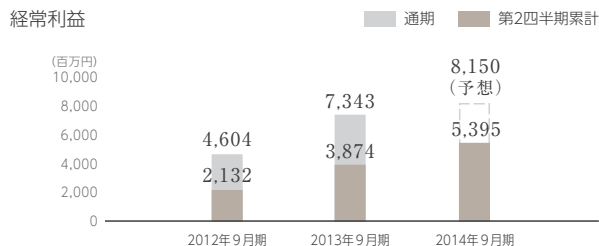
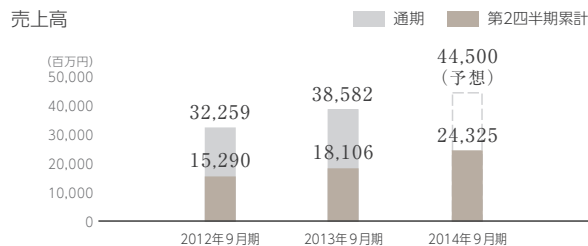
#### SEMICON JAPANに出展

半導体製造装置・材料の国際展示会「SEMICON JAPAN」が、2013年12月に幕張メッセで開催され、当社は、先端エレクトロニクス製品に向けたシリコンウェーハの平坦化要求に、高い生産性と品質で応える、各種研磨装置・消耗副資材の統合アプローチを展示しました。シリコンウェーハの一層の精度向上を実現する最新鋭の両面研磨装置などを紹介するとともに、当社の装置シリーズを組み合わせ、様々な電子素材に対する効果的な製造プロセスについてのプレゼンテーションも併せて行い、国内外から注目を集めました。

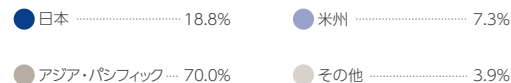
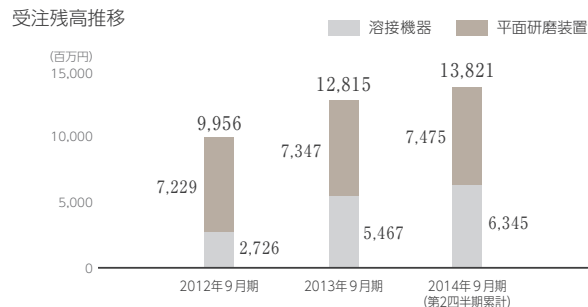
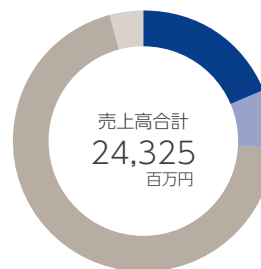


SEMICON JAPAN

## 主要経営指標の推移



### 地域別売上高構成比

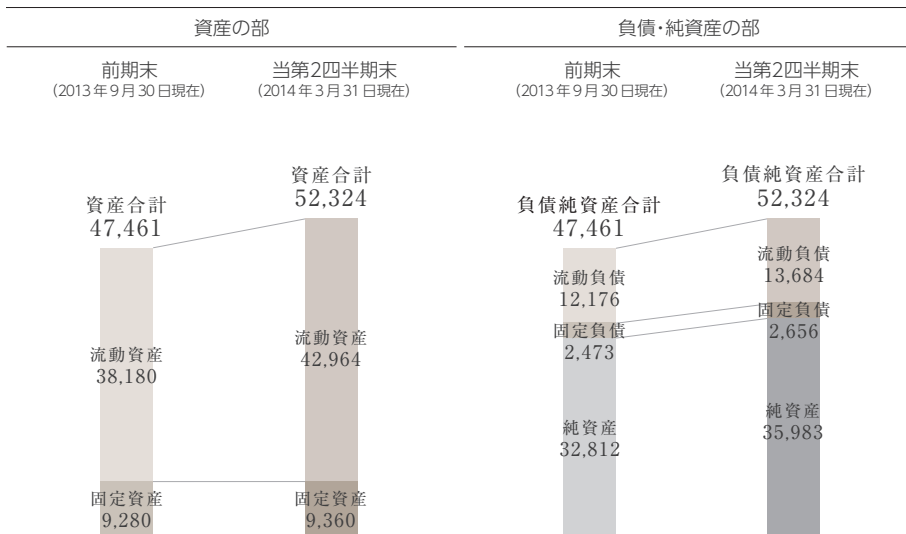


(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

## 連結財務データ

### 資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



### point 1 資産・負債

point  
1

総資産は523億24百万円と、前期末と比べて48億63百万円増加しました。現金及び預金が20億76百万円、受取手形及び売掛金が13億51百万円増加したことなどによります。負債は163億41百万円と、前期末に比べて16億91百万円増加しました。支払手形及び買掛金が2億43百万円、賞与引当金が3億88百万円減少した一方で、短期借入金が6億39百万円、未払法人税等が6億38百万円増加したことなどによります。

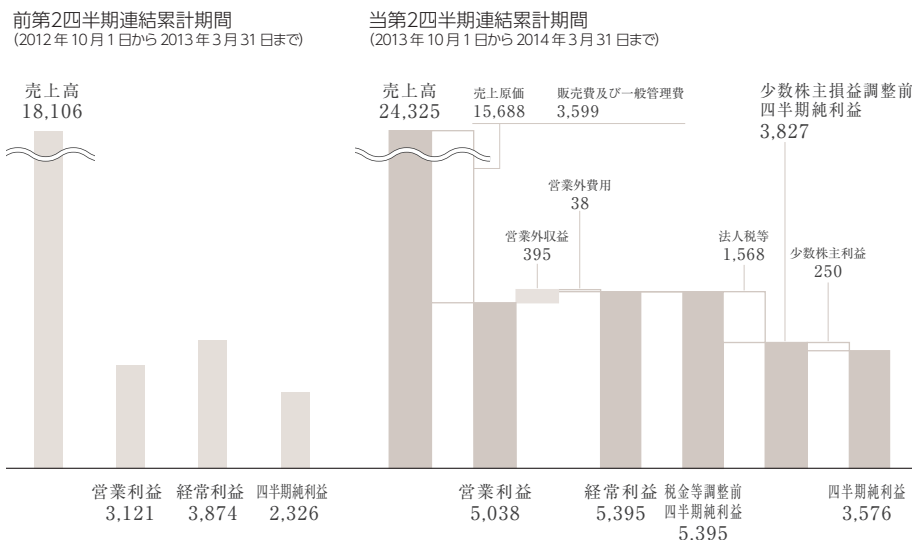
### point 2 純資産

point  
2

純資産は359億83百万円と、前期末に比べて31億71百万円増加しました。自己株式の取得により5億1百万円減少した一方、利益剰余金が27億99百万円、円安により為替換算調整勘定が7億28百万円増加したことなどによります。

## 損益の状況

(単位：百万円)



### point 3 売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益

point  
3

連結売上高243億25百万円(前年同期比34.3%増)、営業利益50億38百万円(前年同期比61.4%増)、経常利益53億95百万円(前年同期比39.3%増)、四半期純利益35億76百万円(前年同期比53.8%増)となりました。

### point 4 営業外収支

point  
4

受取利息97百万円、為替差益216百万円など、営業外収益が3億95百万円となった一方、支払利息25百万円など、営業外費用が38百万円となりました。



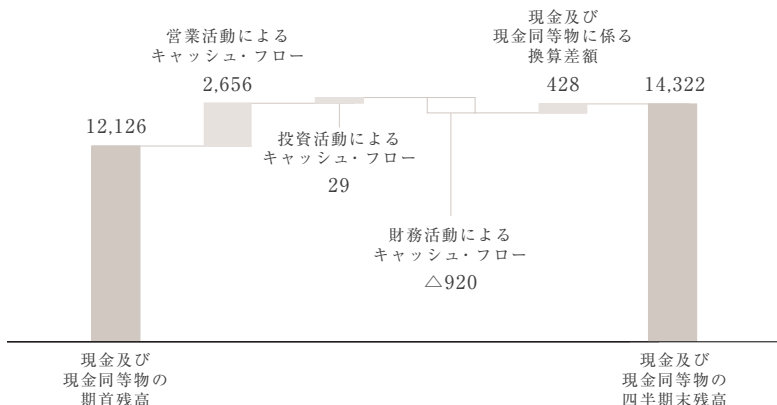
## 連結財務データ

### キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間

(2013年10月1日から2014年3月31日まで)

(単位：百万円)



point  
5

### 営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、26億56百万円となりました。税金等調整前四半期純利益が53億95百万円となった一方、賞与引当金の減少額が4億13百万円、売上債権の増加額が8億51百万円、仕入債務の減少額が4億13百万円、法人税等の支払額が6億44百万円発生したことなどによります。

point  
6

### 投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により得られた資金は29百万円となりました。定期預金の純減少額が1億58百万円、投資有価証券の売却等による収入が48百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が1億71百万円発生したことなどによります。

point  
7

### 財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は9億20百万円となりました。短期借入金の純増加額が5億64百万円となった一方、自己株式の取得による支出が5億1百万円、配当金の支払額が7億74百万円発生したことなどによります。

15

## 会社情報

(2014年3月31日現在)

### 会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	21名(連結 1,652名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-1111 (代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	<a href="http://www.obara-g.com/">http://www.obara-g.com/</a>

### 役員

取締役社長	小原 康 嗣
取締役	小林 憲 史
取締役	周 澤 健
取締役	山下 光 久
常勤監査役	谷 内 博
社外監査役	大 西 倫 雄
社外監査役	村 松 建 夫

(注) 監査役のうち、大西倫雄及び村松建夫の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。

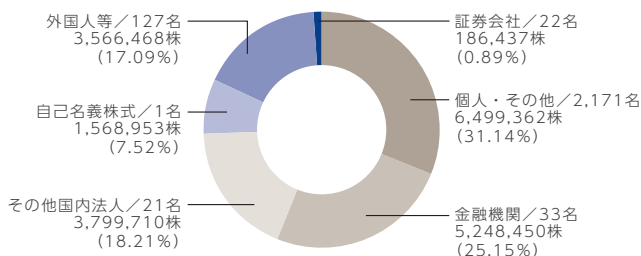
16

## 株式情報 (2014年3月31日現在)

### 株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	2,375名

### 株主分布状況



### 大株主 (上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率 (%)
有限会社馬込興産	3,703	19.19
小原 康嗣	2,261	11.71
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	1,294	6.70
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	1,156	5.99
CMBL S.A. RE MUTUAL FUNDS	553	2.86
株式会社三菱東京UFJ銀行	369	1.91
野村信託銀行株式会社(投信口)	337	1.74
小原 博	310	1.60
小原 範子	304	1.57
資産管理サービス信託銀行 株式会社(証券投資信託口)	238	1.23

- (注) 1. 上記のほか、自己株式1,568千株を保有しております。  
 2. 持株比率は、自己株式1,568千株を控除して計算しております。  
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数774千株を加えて表示しております。

17

### 株主メモ

事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで  
 定時株主総会 毎年12月  
 基準日 定時株主総会の議決権 毎年9月30日  
 期末配当 毎年9月30日  
 第2四半期末配当 毎年3月31日  
 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

株主名簿管理人 〒100-8233  
 東京都千代田区丸の内1-4-1  
 三井住友信託銀行株式会社  
 特別口座の  
 口座管理機関 東京都千代田区丸の内1-4-1  
 三井住友信託銀行株式会社  
 同事務取扱所 〒168-0063  
 東京都杉並区和泉2-8-4  
 (郵便物送付先) 三井住友信託銀行株式会社  
 お問い合わせ先 証券代行部  
 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)

同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

公告方法 当公司公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。  
<http://www.obara-g.com/>  
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行なうことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

18